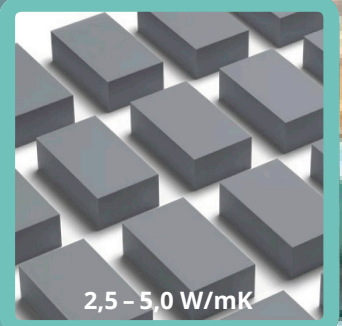


NEUESTE PRODUKTLINIE: SILIKONFREIE GAPFILLER- SOFT-PAD-SF-HP- & EP-SERIE

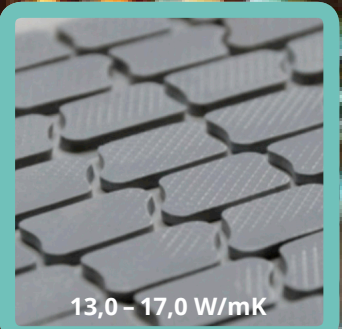
ICT-TC-GFSP-SF-5010 | 5011 | 5012 SERIE



ICT-TC-GFSP-SF-HP-5030 | 5031 | 5032 SERIE***



ICT-TC-GFSP-SF-EP-5040 | 5041 | 5042 SERIE****



**HIGH PERFORMANCE SETZT EXZELLENTES
THERMALMANAGEMENT VORAUSS**

SILIKONFREIE GAPFILLER-SOFT-PADS

DIE NEUSTE T.I.M.-GENERATION VON ICT SUEDWERK

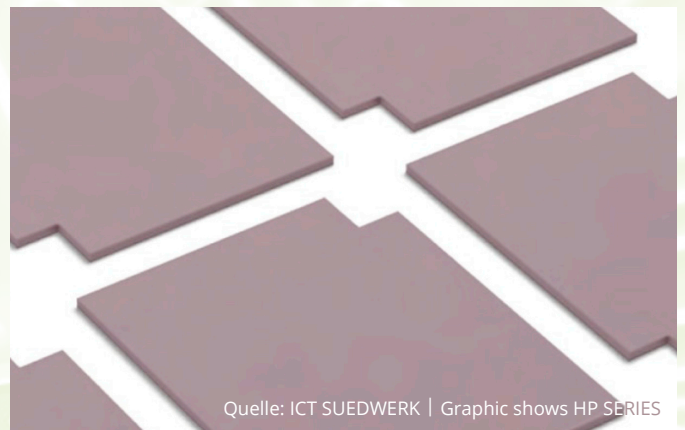
Silikonfreie Wärmeleitpads wurden speziell entwickelt, um Probleme mit der Verflüchtigung von Siloxanen und dem Ausbluten von Silikonöl zu vermeiden. Dadurch eignen sie sich für silikonsensitive Anwendungen, beispielsweise in der Optik-, Medizin- und Präzisionselektronikindustrie. Obwohl sie im Preis etwas höher sind, verhindern sie wirksam Kontaminationen und Ausfallrisiken, die mit silikonbasierten Materialien verbunden sind. Silikonfreie Wärmeleitpads sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen silikonbasierte Materialien nicht geeignet sind, z. B. in Umgebungen, in denen eine Silikonverunreinigung vermieden werden muss. Silikonfreie Gapfiller-Pads bieten eine vergleichbare Wärmeleitfähigkeit und Flexibilität, werden jedoch aus alternativen Materialien hergestellt, die das Risiko von Ausgasungen oder Verunreinigungen ausschließen.

WAS IST NIEDERMOLEKULARES SILOXAN?

Die chemische Formel zeigt, dass nicht reaktives cyclisches Polydimethylsiloxan $\text{HO}[\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{O}]_n\text{H}$ flüchtig ist und sich jederzeit verflüchtigen kann. Wenn beispielsweise elektronische Produkte in geschlossenen Umgebungen betrieben werden, können niedermolekulare Siloxane unter Umständen die elektrischen Kontakte beeinträchtigen.

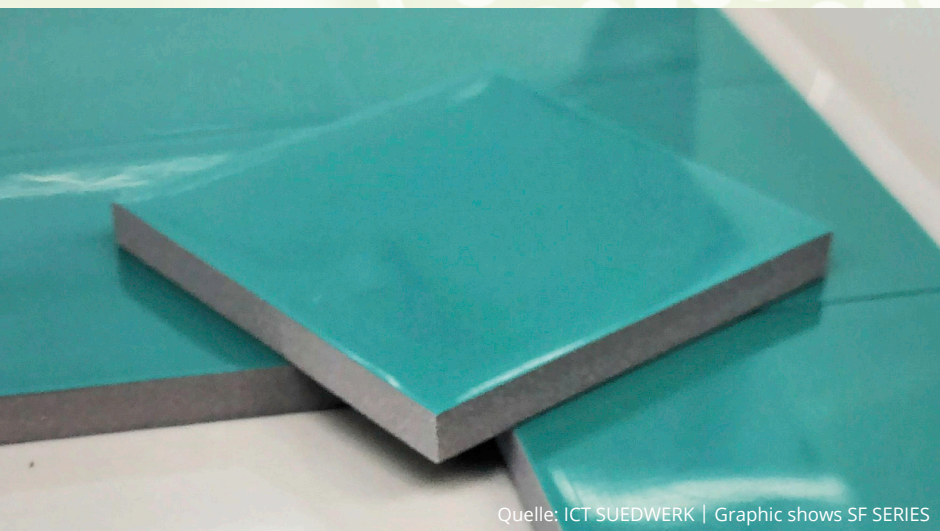
WARUM WERDEN SILIKONFREIE WÄRMELEITMATERIALIEN IN HOCH-TECHNISCHEN, EMPFINDLICHEN BEREICHEN VERWENDET?

Silikonfreie Wärmeleitmaterialien sind in hochtechnischen, empfindlichen Bereichen wie Optik, Medizinprodukten und Halbleiter von entscheidender Bedeutung. In diesen Anwendungen können selbst geringste Mengen an Silikonausgasungen zu schwerwiegenden Ausfällen oder Verunreinigungen führen. In optischen



Quelle: ICT SUEDWERK | Graphic shows HP SERIES

Geräten können beispielsweise flüchtige Silikonverbindungen auf den Oberflächen der Komponenten kondensieren und zu Beschlagbildung oder einer Verschlechterung der optischen Leistung führen. In medizinischen Geräten können Silikonrückstände Abstoßungsreaktionen auslösen oder empfindliche Komponenten verunreinigen, während in der Halbleiterfertigung und bei Verpackungsprozessen Silikonverunreinigungen Leistung, Zuverlässigkeit und Produktionsausbeute der Chips direkt beeinträchtigen können.



Quelle: ICT SUEDWERK | Graphic shows SF SERIES



TECHNISCHE BERATUNG

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen über produktspezifische Datenblätter? Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns!

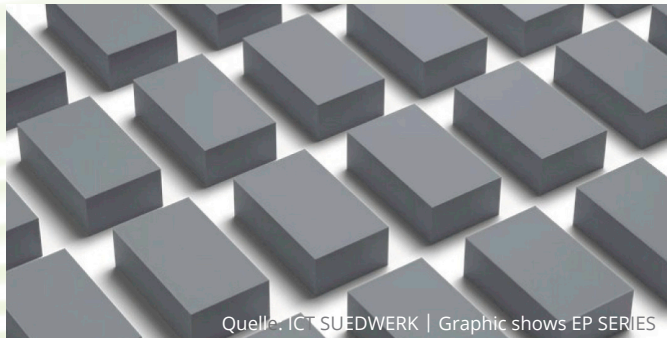
T + 49 (0)89 21 23 102-0
info@ict-suedwerk.de

SILIKONFREIE GAPFILLER-SOFT-PADS

DIE PERFEKTE THERMISCHE GAPFILLER LÖSUNG

SILIKONFREIER THERMISCHER GAPFILLER-SOFT-PAD & GERINGE AUSGASUNG

Im Bereich des Wärmemanagements für moderne elektronische Geräte lösen silikonfreie Wärmeleitpads effektiv die Probleme der Ausgasung von niedermolekularem Siloxan (LMS), die bei herkömmlichen Materialien auf Silikonbasis auftreten. Dadurch wird eine mögliche Verunreinigung von präzisen elektronischen und optischen Bauteilen verhindert, elektrische Kontaktfehler vermieden und die langfristige Zuverlässigkeit und Leistungsstabilität erheblich verbessert.



SILIKONFREIER THERMISCHER GAPFILLER-SOFT-PAD: DIE PERFEKTE THERMISCHE LÖSUNG

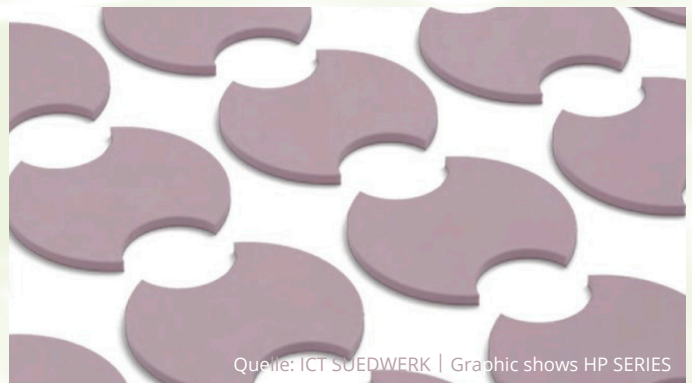
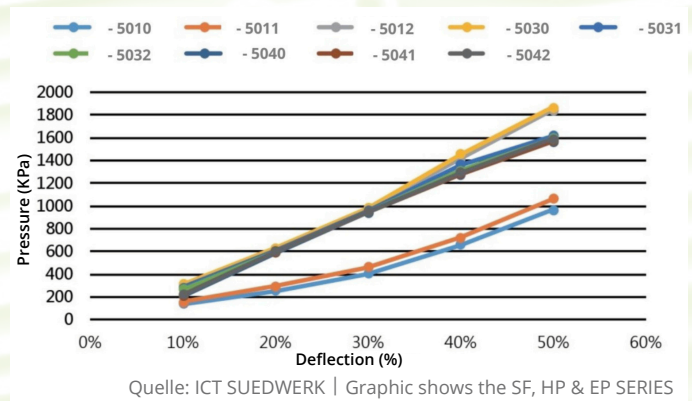
Die neueste Gapfiller-Soft-Pad-Serie von ICT SUEDWERK auf Basis von silikonfreiem EP-Harz und thermoplastischen Elastomeren (TPE) eignet sich ideal für den Einsatz in optischen Produkten und anderen empfindlichen elektronischen Bauteilen, bei denen Silikon die elektrischen Kontakte nicht beeinträchtigen darf. Die ICT-TC-GFSP-SF-(HP|EP)-Serie hat eine Shore 00-Härte 50–60 und bietet eine ausgezeichnete Kompressibilität von 20–60%*, gemessen nach ASTM D5470 (*bei 30 psi).

Diese neuesten Produkte der silikonfreien Gapfiller-Soft-Pad-Serie füllen Gaps zwischen den Kontaktflächen effektiv aus, beseitigen Luft einschüsse und ermöglichen eine effiziente Wärmeübertragung an Kühlkörper oder die Umgebung, wodurch der thermische Übergangswiderstand gemäß ASTM D5470 auf 0,06–0,84 °C·inch²/W reduziert wird.

Silikonfreie Gapfiller-Pads versus Silikonbasierte Gapfiller-Pads

SILIKONFREIES THERMISCHES GAPFILLER-SOFT-PAD-MATERIAL, UMWELTKONFORMITÄT UND FLAMMWIDRIGKEIT:

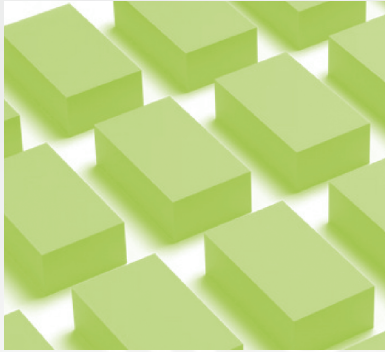
Nicht-Silikonhaltige Gapfiller-Pads entsprechen den REACH- und RoHS-Richtlinien und erfüllen die Anforderungen der Flammwidrigkeit gemäß UL 94 V-0, wodurch ein hohes Maß an Sicherheit und Umweltkonformität gewährleistet ist.



SILIKONFREIE GAPFILLER-SOFT-PAD-SERIE

WICHTIGE TECHNISCHE MERKMALE

ICT-TC-GFSP-SF-5010 | 5011 | 5012 SERIE



WICHTIGSTE TECHNISCHE MERKMALE

TYP	HÄRTE Shore 00	SPEZIFISCHES GEWICHT	R_{th}^*	W/mK**	kv/mm	UL 94 V0
5010	60	2,4 g/cm ³	0,682	2,5	16	JA
5011	60	2,6 g/cm ³	0,543	3,0	16	JA
5012	55	3,2 g/cm ³	0,208	5,0	8	JA

LEGENDE: * R_{th} = °C inch²/W | Materialproben-Stärke 1,0 mm (Druck 20 psi)
** W/mK gemäß ASTM D5470

ICT-TC-GFSP-SF-HP-5030 | 5031 | 5032 SERIE***



WICHTIGSTE TECHNISCHE MERKMALE

TYP	HÄRTE Shore 00	SPEZIFISCHES GEWICHT	R_{th}^*	W/mK**	kv/mm	UL 94 V0
5030	60	3,3 g/cm ³	0,182	7,0	8	JA
5031	50	3,4 g/cm ³	0,166	9,0	8	JA
5032	50	3,3 g/cm ³	0,148	11,0	8	JA

LEGENDE: * R_{th} = °C inch²/W | Materialproben-Stärke 1,0 mm (Druck 20 psi)
** W/mK gemäß ASTM D5470
*** HP = Hochleistungsserie

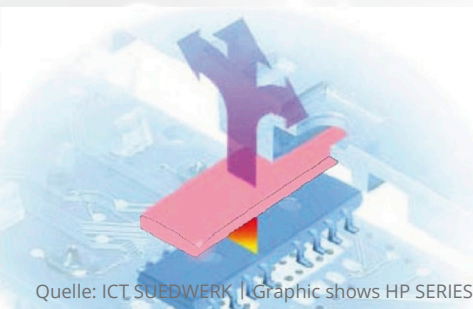
ICT-TC-GFSP-SF-EP-5040 | 5041 | 5042 SERIE****



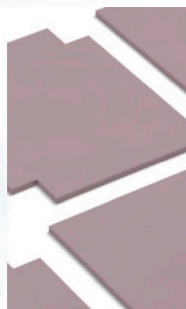
WICHTIGSTE TECHNISCHE MERKMALE

TYP	HÄRTE Shore 00	SPEZIFISCHES GEWICHT	R_{th}^*	W/mK**	kv/mm	UL 94 V0
5040	50	3,3 g/cm ³	0,131	13,0	00	JA
5041	50	3,3 g/cm ³	0,119	15,0	00	JA
5042	50	2,4 g/cm ³	0,103	17,0	00	JA

LEGENDE: * R_{th} = °C inch²/W | Materialproben-Stärke 1,0 mm (Druck 20 psi)
** W/mK gemäß ASTM D5470
**** EP = Serie mit ausgezeichnete Leistung



Quelle: ICT SÜEDWERK | Graphic shows HP SERIES



LIEFERFORMEN

Alle Produkte sind gemäß Zeichnungsvorlage in Standardabmessungen als Bogen sowie in unterschiedlichen Stärken von 0,50mm – 10,00 mm erhältlich.

Weitere Materialstärken auf Anfrage.

www.ict-suedwerk.de

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem technischen Datenblatt nicht über die darin beschriebenen Spezifikationen hinausgehen und lediglich die typische Leistung des Produkts als Einzelkomponente erläutern. Daher muss der Anwender die Eignung und Installation des Produkts vor der Verwendung prüfen und testen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Abbildungen sowie technische Merkmale können vom Original abweichen.